

tesa[®] HAF 8440

製品情報



HAF熱活性接着フィルム

ICスマートカードにチップモジュールの装着用

製品の説明

tesa HAF 8440 は熱可塑性コポリアミドを主成分にした熱活性両面接着フィルムです。

製品特性：

- 優れた耐老化性* カードに実装しても透明ですので目立ちません

用途例

- PVC、ABS、PET、PC 等の各種カード[®] 材質に適用。
- 全てのIC カード[®] 装着ラインに適合。
- IC スマートカード[®] のチップモジュールの装着、様々な用途に装着可能。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

・ 基材	無し	・ ライナー	グラシン
・ 粘着剤	コポリアミド	・ テープ厚	40 μm

特性／性能

- 接着力（プッシュアウト） 7 N/mm²

免責事項

tesa[®]（テサ[®]）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=8440>